

Lagenaufbau

Ebe	ne		Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Тур
		A B	Cu+galv.Cu		18+25	
1			Prepreg	0.048		106
			Prepreg	0.048		106
2			Cu Tr-Lam Cu	0.20	35 35	
3			Prepreg	0.048		106
			Prepreg	0.048		106
4			Cu Tr-Lam Cu	0.20	35 35	
5			Prepreg	0.048		106
			Prepreg	0.048		106
6			Cu-Lam Tr-Lam Cu	0.20	35 35	
7			Prepreg	0.048		106
			Prepreg	0.048		106
8			Cu Tr-Lam Cu	0.20	35 35	
9			Prepreg	0.048		106
			Prepreg	0.048		106
10			Cu+galv.Cu		18+25	

	Presslingsdicke *	1,54	+/- 10%	
Gesamtdicke inkl. galv. Cu u	ı. Lötstoppmaske *	1,65	+/- 10%	

Bemerkungen zum Lagenaufbau:

Multilayer 10 Lagen - 1,5/1,6 mm - Microvia



- * Dickenberechnung mit Basismaterial FR-4 ungefüllt bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)
- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe

Designrules zum Lagenaufbau

Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 200 µm					
(Vido)	Viapad-Ø	≥ 500 µm					
Lasersacklöcher [B] (blind Vias)	End-Ø	≥ 100 µm					
(Sima viao)	Viapad-Ø	≥ 350 µm					
Leiterbild Außenlagen							
	Leiterbreite bei 9 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 9 µm Grundkupfer	≥ 80 µm ≥ 100 µm					
Standard	Leiterbreite bei 18 μm Grundkupfer Leiterabstand bei 18 μm Grundkupfer	≥100 µm ≥ 120 µm					
Leiterbild Innenlagen							
	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 65 µm ≥ 80 µm					
Standard	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥85 µm ≥ 100 µm					